中信证券股份有限公司

关于苏州法特迪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年六月

声　明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

目　录

声　明 1

目　录 2

第一节 发行人基本情况 3

一、发行人基本情况 3

二、发行人主营业务 3

三、发行人核心技术和研发水平 4

四、主要经营和财务数据及财务指标 7

五、发行人面临的主要风险 8

第二节 本次证券发行基本情况 13

一、本次发行情况 13

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 14

三、保荐人与发行人的关联关系 15

四、保荐人内部审核程序和内核意见 16

第三节 保荐人承诺事项 18

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 19

一、推荐意见 19

二、发行人本次证券发行履行的决策程序 19

三、发行人板块定位情况 20

四、发行人符合上市条件 24

第五节 上市后持续督导工作安排 29

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州法特迪科技股份有限公司
英文名称	FTDevice Technology (Suzhou) Co., Ltd.
注册资本	3,900.00 万元
法定代表人	王强
有限公司成立日期	2014 年 2 月 11 日
股份公司成立日期	2023 年 11 月 22 日
注册地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202
主要生产经营地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202
邮政编码	215000
电话	0512-65916786
传真	0512-65916786
互联网网址	https://www.ftdevice.com
电子信箱	ftdzqb@ftdevice.com
信息披露和投资者关系的负责部门	证券业务部
信息披露和投资者关系的负责人	张辉
信息披露和投资者关系的电话号码	0512-65916786

二、发行人主营业务

公司是行业领先的半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售，覆盖半导体领域从芯片设计至量产交付的全生命周期，为芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等半导体产业链关键环节客户提供封装测试消耗型硬件解决方案。公司产品主要应用于 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，实现了高性能芯片封装测试消耗型硬件的国产替代，助力我国集成电路产业的自主可控及战略升级。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业。

半导体封装测试消耗型硬件是连通测试设备与待测芯片之间的核心纽带，主要承担低损耗高速信号传输、严苛测试环境维持以及高精度定位接触等功能，其自身的技术指

标直接决定了芯片整体测试方案的精度与效率。在芯片设计的工程验证阶段，公司产品可协助客户识别芯片设计缺陷、优化封装方案并提高芯片研发验证效率；在芯片量产的成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）和系统级测试（SLT）阶段，公司产品可保障客户有效筛除芯片性能偏差、提高芯片交付良率及可靠性。

公司凭借核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力，已深入参与全球高性能半导体封装测试消耗型硬件市场竞争。

三、发行人核心技术和研发水平

（一）发行人的核心技术

公司始终重视研发投入和技术创新，通过自主研发形成了在高性能芯片测试解决方案领域突出的技术壁垒和竞争优势，公司的核心技术体系具体如下：

技术方向	技术名称	技术描述	技术先进性或难点	具体表征	技术所处阶段	技术来源
面向高频高速信号的测试座设计与制造	阻抗匹配与高速信号无损耗传输技术	面向高速信号测试，构建“同轴探针结构+低介电灌胶材料+全链路仿真优化”的测试座设计方案，实现芯片引脚、测试座至测试板端的低损耗、阻抗连续传输	高速测试中探针变径、介质损耗及阵列串扰易导致反射和衰减，公司产品通过低损耗灌胶、多孔控制环及系统级仿真，提升阻抗匹配精度并兼容多阻抗场景	支持 56Gbps 及以上高速测试；阻抗覆盖 50Ω-150Ω；介电常数≤2.2，介质损耗因子＜0.005；灌胶无明显气泡；全链路阻抗匹配偏差≤3%	正式应用	自主研发
	高精度、超低电阻设计与检测技术	面向多接触点的高密度测试座，基于全开尔文四线制测量、高密度开关矩阵及多 SMU 并行架构，实现接触电阻的快速、定量化全检，消除从测试机到探针的引线电阻与接触电阻误差	万级触点逐点检测对测试效率、测量精度及通道一致性要求高，传统外观检测难以识别接触隐患。该技术可消除引线与接触路径误差，提升上机前质量筛查能力	支持 10,000+通道扫描；12 组以上 SMU 并行测试；电阻测量范围 1mΩ-10kΩ；测量精度±0.05%，重复性优于 0.5%；单点测试＜10ms，万点全检＜5 分钟	正式应用	自主研发
	晶圆测试高速探针卡设计技术	面向晶圆级高速测试场景，采用同轴探针结构、低损耗灌胶及短链路布局，降低探针卡信号路径引起的反射、衰减和串扰	晶圆测试中通道密度高、传输路径受限，高速信号易受链路长度、介质材料和探针间距影响。该技术在较小探针间距下实现高速信号稳定传输	适用于 250μm 及以上探针间距；支持最高 224Gbps 高速信号测试；采用同轴探针与低损耗灌胶结构	正式应用	自主研发
宽温区高功率老化座设计与制造	精准控温以及宽温区老化座设计与制造技术	面向百瓦级的高功率芯片老化测试，采用铜底座、毛细铜管、铝翅片复合散热结构，集成加热、测温、闭环控制单元及风冷系统，实现宽温区稳定控温	难点在于高功率热负载下兼顾散热效率、温度均匀性和宽温区控制精度。公司产品通过低热阻结构、毫秒级温度采样及功率前馈+串级 PID 算法，提升风冷老化座控温能力	支持百瓦级持续散热；温度采样 10-20ms；850W 阶跃负载下温度过冲≤±3℃，稳态波动≤±1℃	正式应用	自主研发
	超高功率液冷老化座设计制造技术	面向千瓦级及以上高性能芯片老化测试，将微通道液冷冷板与高精度压合测试座一体化集成，实现超高功率散热、精密压接和温度闭环控制	在有限空间内同时满足大功率散热、芯片压接稳定、液冷密封及绝缘安全要求，通过多级微流道、低热阻界面材料及分区压合结构提升系统可靠性	入口水温 40℃、流量 2L/min 条件下可散逸 2,000W 左右热量；芯片表面温度 105±1.5℃；结温≤120℃；面内温差≤4℃；接触热阻＜0.05K cm²/W；冷板耐压 0.8MPa 无泄漏	正式应用	自主研发
	多区独立控温与三温测试控制技术	面向三温测试和多工位并行测试，基于 TEC 双向控温、主从式总线架构和多区独立 PID 控制，实现各测	多区密集控温需解决升降温速度、温度精度、区域热耦合及低温结露问题，通过增益调度 PID、热耦合	支持 24 个温区同步独立控制；升降温时间＜5 分钟；支持常温环境下三温测试及高	正式应用	自主研发

技术方向	技术名称	技术描述	技术先进性或难点	具体表征	技术所处阶段	技术来源
		试位点的同步、独立温度管理	补偿和露点保护逻辑提升测试效率和稳定性	温老化测试		
高性能测试探针设计	高速射频同轴探针设计技术	面向高频高速芯片测试，采用同轴探针架构、50Ω 阻抗匹配设计及渐变过渡结构，降低寄生参数、信号损耗和通道串扰	高频射频探针对探针几何精度、介质稳定性及接地屏蔽连续性要求高，微小结构偏差均可能引发阻抗突变。该技术通过全波仿真和结构参数优化实现高频性能稳定	实现 50Ω 特征阻抗匹配；变径比＜1.2；测试压缩行程＞0.7mm；可抑制寄生电容、串扰及信号损耗	正式应用	自主研发
高精度微间距测试座精密制造	超大封装测试座平面度控制技术	面向超大尺寸多孔薄板测试座，采用贴膜增强、真空压膜、阶梯固化、对称约束及真空吸附加工工艺，控制灌胶固化和后加工过程中的翘曲变形	大尺寸薄壁多孔结构在灌胶固化及热循环中易产生应力释放和基准偏移，直接影响探针阵列共面性。该技术通过工艺路径和约束方式优化，实现高平面度和高良率制造	适用于大尺寸、孔数＞5,000 的多孔板；固化翘曲量由 1.5mm 降至 0.15mm 以内；平面度≤0.01mm；位置精度 ±0.02mm	正式应用	自主研发
	高密度阵列、微孔灌胶制造技术	面向高密度微孔阵列填充，采用高压射出成型、直接浇口及变模温控制工艺，实现树脂在微孔阵列中的完整填充和稳定固化	高密度阵列灌胶易发生气泡、短射、收缩和翘曲，影响后续加工及信号性能。该技术通过注射压力、填充速度、模具温度和压缩压力协同控制，提高填充一致性	支持高密度孔阵列填充；可实现 0.1mm 微孔完整填充；无明显气泡、短射等缺陷；制品收缩率降低约 1.5%-2%；材料利用率提升	正式应用	自主研发
测试分选套件精密制造	测试压头定位、多功能检测及温控技术	面向分选机换型及三温测试组件，集成高精度定位、多通道真空吸附、独立加热及多功能检测模块，实现压头与测试座、待测芯片的快速适配	在有限空间内同时满足设备接口、封装尺寸、压接行程、温控及检测功能要求，通过模块化结构和集成检测设计提升换型效率及装配一致性	实现分选机、测试座与芯片之间的高精度机械匹配；支持真空吸附、加热、定位及多项功能检测；提升三温设备组件检测效率和正确率	正式应用	自主研发
高速测试机接口模组制造	高速接口模组制造技术	面向 ATE 测试机头与待测芯片之间的高速互连，采用高密度同轴结构、精密针孔定位及低收缩灌胶工艺，形成宽带低损耗的信号传输通道	超高引脚数接口模组需在有限空间内兼顾高密度排布、机械寿命、共面度和高速信号传输完整性。该技术通过同轴屏蔽、精密研磨及灌胶固化控制降低损耗和串扰	支持多信号通道；机械寿命＞50 万次插拔	正式应用	自主研发

（二）发行人的研发水平

1、核心技术的科研实力和成果情况

截至本上市保荐书签署日，公司获得的主要奖项、荣誉情况如下：

序号	奖项或荣誉名称	颁发单位	颁发年度
1	国家级专精特新重点“小巨人”企业	工业和信息化部	2024 年
2	江苏省专精特新中小企业	江苏省工业和信息化厅	2022 年
3	江苏省企业技术中心	江苏省工业和信息化厅	2024 年
4	江苏潜在独角兽企业	江苏省生产力促进中心	2024 年
5	2022 年度苏州市独角兽培育企业	苏州市科技局	2023 年
6	2023 年江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业	江苏省生产力促进中心	2023 年
7	2023 年度江苏省科技企业上市培育计划入库企业	江苏省科学技术厅	2023 年
8	苏州市企业技术中心	苏州市工业和信息化局	2022 年
9	江苏省集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心	江苏省科学技术厅	2020 年
10	苏州市半导体测试技术工程中心	苏州市科学技术局	2017 年

2、专利及软件著作权情况

截至本上市保荐书签署日，公司取得了 66 项发明专利、67 项实用新型专利、1 项境内软件著作权。

四、主要经营和财务数据及财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	60,216.79	38,790.29	26,600.20
归属于母公司所有者权益（万元）	41,297.42	28,950.25	21,049.54
资产负债率（合并）	31.42%	25.37%	20.87%
资产负债率（母公司）	36.64%	33.08%	31.51%
营业收入（万元）	54,402.48	30,951.23	22,547.96
净利润（万元）	13,197.53	6,167.86	3,831.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,197.53	6,167.86	3,831.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	12,339.83	5,647.92	3,447.42
基本每股收益（元）	3.38	1.63	1.03
稀释每股收益（元）	3.38	1.63	1.03

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
加权平均净资产收益率	37.57%	24.95%	18.69%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,061.91	1,065.68	3,167.65
现金分红（万元）	1,950.00	-	2,500.00
研发投入占营业收入比例	3.91%	4.67%	4.98%

五、发行人面临的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、技术风险

（1）产品研发与技术开发风险

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,122.79 万元、1,446.38 万元和 2,126.55 万元，公司研发投入金额持续增长。未来随着应用领域的拓展、市场需求的变动以及技术水平的提升，公司需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级以保持核心竞争力。公司研发项目具有资金投入规模大、技术难度高、项目周期长的特点，如果公司未能准确把握市场发展趋势，或未来研发资金不足，可能导致公司研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（2）技术人才流失风险

公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型产业。随着行业技术水平的不断发展，公司对高端研发人才的需求将日益增长。未来，若公司薪酬水平较同行业竞争对手丧失竞争优势，或人力资源政策及内部晋升制度未能得到有效执行，公司可能无法持续引进高端技术人才，甚至出现现有骨干技术人员流失的情形，从而对公司的持续创新能力造成不利影响。

（3）知识产权保护相关的风险

公司所处的行业属于知识密集型、技术密集型产业，知识产权保护对公司的核心技术积累、持续研发能力和市场竞争力具有重要意义。公司在产品研发过程中涉及专利等多项知识产权，需通过申请专利等方式保护自身核心技术，并降低侵犯他人知识产权的风险。但相关措施无法完全避免公司与竞争对手等相关方产生知识产权争议，或公司的

知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能，相关情形可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

2、经营风险

（1）客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户实现营业收入分别为 9,800.78 万元、15,587.86 万元和 35,815.76 万元，占当期营业收入的比重分别为 43.47%、50.36%和 65.83%，客户集中度相对较高。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，若未来公司主要客户经营情况发生重大问题或公司与客户合作关系发生不利变化，公司可能面临客户订单减少或客户流失等风险，进而影响公司生产经营，对公司的业绩造成不利影响。

（2）产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，而公司产品的质量和性能受到原材料质量、产品设计、生产制造等多种因素的影响，无法完全排除因不可控因素出现产品质量问题的可能。如果公司产品在生产或使用过程中出现性能不稳定或质量问题，可能影响客户满意度，甚至引发质量纠纷或客户流失，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

（3）税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、集成电路企业增值税加计抵减政策、研究开发费用加计扣除、小微企业税收优惠等。如果未来国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，导致公司适用的税收优惠政策发生不利变化，或者公司因未能持续维持国家高新技术企业资格等原因无法继续享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（4）经营场所租赁的风险

报告期内，公司部分生产经营场所通过租赁方式取得。虽然公司相关经营场所的租赁关系处于持续稳定状态，但仍不排除未来出现租赁合同无法继续履行、到期无法续租、租金大幅上涨或出租方违约等情形。如果发生上述情形，公司可能因需要搬迁而产生额外费用，并可能在短期内影响公司的正常经营。

3、财务风险

（1）经营业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 22,547.96 万元、30,951.23 万元和 54,402.48 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 3,831.75 万元、6,167.86 万元和 13,197.53 万元；得益于下游应用领域市场需求持续强劲、半导体封装测试消耗型硬件国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素，公司报告期内营业收入实现大幅增长。如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司新产品推广不及预期、原材料成本上升、公司研发投入加大、已实施或新增股权激励导致的大额股份支付费用等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司可能面临经营业绩下滑的风险，极端情况下有可能存在上市当年营业利润同比下滑超过 50%甚至亏损的风险。

（2）毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 36.66%、35.90%和 38.29%。公司产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。未来，公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降，或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动，都可能导致公司毛利率水平出现波动，给公司的经营带来一定风险。

（3）应收账款坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 8,096.98 万元、14,649.38 万元及 30,446.29 万元，占当期营业收入的比例分别为 35.91%、47.33%及 55.96%，应收账款坏账准备分别为 416.39 万元、732.47 万元和 1,522.52 万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账损失风险的可能性将会增加。

（4）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面余额分别为 4,325.74 万元、6,052.63 万元和 10,347.85 万元，其跌价准备分别为 1,164.70 万元、1,166.58 万元和 1,375.11 万元，呈现快速增长

态势。随着公司业务规模的持续扩大，预计未来存货规模或将相应上升。虽然公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，以客户订单需求为导向组织生产，但产品从原材料采购、生产出货至客户签收或验收需要经历一定周期，若未来因市场环境出现重大不利变化、产品更新迭代或客户需求变化等原因导致公司原材料等出现积压、库存商品等出现滞销或贬值，公司存货将面临产生跌价损失的风险，从而影响公司的经营业绩和财务状况。

（二）与行业相关的风险

1、市场竞争加剧风险

公司是国内领先的半导体封装测试消耗型硬件解决方案供应商，专注于设计、开发与制造高性能测试座及相关配套产品。但是和国际龙头企业相比，公司在市场占有率、产品成熟度、多应用领域经验等方面仍然存在诸多差距；同时，随着行业内其他厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，也不排除出现部分国内厂商抢占市场份额，公司所处行业市场竞争日趋激烈的情形。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

2、宏观经济及行业周期性波动风险

公司产品和服务目前主要面向半导体测试领域。其中，半导体行业与宏观经济形势密切相关，其需求直接受到芯片制造及终端应用市场的影响。尽管半导体行业面临全球化竞争与合作，并属于国家政策大力支持的战略新兴行业，但其受到国内外宏观经济、行业发展规律、行业法规和产业政策等因素的影响，存在一定的周期性。如果未来国内外宏观经济增长放缓或产业政策支持力度减弱使得行业发生周期性波动，可能导致公司产品的市场需求未来短期内有所下降，从而对公司的业务发展和经营业绩产生一定的不利影响。

（三）其他风险

1、发行失败风险

本次发行上市相关文件须经过深圳证券交易所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过深交所审核并取得中国证监会予以注册决定存在不确定性。本次发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的综合

影响，若上述因素出现不利变动，本次发行存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

2、募投项目实施的风险

本次募投项目基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境、产业政策和未来技术发展方向制定。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精准预测，项目实施过程中可能出现投资额变动、无法按期投产等问题，从而导致募投项目实施效果无法达到预期的效益水平，甚至对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。

3、募投项目新增折旧和摊销影响公司盈利能力的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后，资产规模将大幅增加，导致各年折旧和摊销费用相应增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧和无形资产产生的摊销，则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司未来的净利润和净资产收益率。

第二节 本次证券发行基本情况

一、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,300.0000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,300.0000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 5,200.0000 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】	发行前每股收益	【】
发行后每股净资产	【】	发行后每股收益	【】
发行市净率	【】（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润	无		
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	先进生产基地建设项目		
	针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目		
	总部及研发中心项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元。其中：承销及保荐费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行新股的，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照深交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件		

拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

孟硕，男，证券执业编号：S1010722010008，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与的项目主要有：苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市、上海数据港股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市、三安光电股份有限公司非公开发行股票、江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转债、上海数据港股份有限公司非公开发行股票、金能科技股份有限公司非公开发行股票、深圳拓邦股份有限公司公开发行可转债、上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、江南模塑科技股份有限公司发行股份购买资产项目等。

王风雷，男，证券执业编号：S1010718100003，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与的项目主要有：江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、上海海希工业通讯股份有限公司精选层公开发行、江苏东方盛虹股份有限公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市、河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票、河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票、濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票、上海数据港股份有限公司非公开发行股票、安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票、盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转债、南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转债、平顶山天安煤业股份有限公司公开发行公司债券、河南辉煌科技股份有限公司公开发行公司债券、中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金、江苏东方盛虹股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金、海澜集团有限公司收购凯诺科技股份有限公司财务顾问项目、河南能源化工集团有限公司收购义马煤业集团股份有限公司及河南大有能源股份有限公司财务顾问项目、永卓控股有限公司收购江苏富淼科技股份

有限公司财务顾问项目、长江存储控股股份有限公司财务顾问等项目。

（二）项目协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定王娴作为法特迪首次公开发行股票并在创业板上市项目的项目协办人，指定艾华、钱欣、陈俊杰、沈宇桥、杨志伟、姚荻川、黄凯作为法特迪首次公开发行股票并在创业板上市项目的项目组成员。

王娴，女，证券执业编号：S1010121050112，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾负责或参与的项目主要有：无锡先导智能装备股份有限公司 H 股发行并在香港联交所主板上市、苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市、伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票、江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转债等项目。

（三）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层

联系电话：021-20262230

三、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本上市保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在拥有发行人权益，以及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）内核意见

2026 年 5 月 7 日，在中信证券大厦 26 层 3 号会议室召开了法特迪首次公开发行股票并在创业板上市项目内核会，内核委员会对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意法特迪首次公开发行股票并在创业板上市项目申请文件对外申报。

第三节 保荐人承诺事项

一、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

二、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

四、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

五、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

六、保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

八、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

九、保荐人将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，自愿接受证券交易所的自律监管。

若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见

一、推荐意见

中信证券根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩持续增长，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

二、发行人本次证券发行履行的决策程序

（一）董事会审议通过

发行人第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，并提请发行人股东会批准。

（二）股东会审议通过

发行人 2026 年第一次临时股东会、2026 年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述董事会、股东会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

三、发行人板块定位情况

（一）公司所属行业符合创业板定位

公司主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。同时，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》，公司主营业务所属领域为“鼓励类”之“信息产业”相关条目，符合战略性新兴产业的发展方向。

综上，公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条“负面清单”规定的行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求

创业板定位相关标准（一）	是否符合	指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元	☑ 是 ☐否	2023-2025 年度，公司研发投入分别为 1,122.79 万元、1,446.38 万元和 2,126.55 万元，研发投入复合增长率 37.62%
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	☑ 不适用	发行人最近一年营业收入超过 3 亿元，不适用《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条指标（一）规定的营业收入复合增长率要求

综上，公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于创业板定位相关标准（一）的要求。

（三）关于符合创业板定位的具体说明

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的具体情况

半导体产业系国家战略性、基础性与先导性产业。测试接口作为贯穿芯片设计验证、晶圆制造及测试、先进封装及测试及系统级测试的核心硬件，其自主可控水平直接关系到我国半导体产业链的安全性与核心竞争力。近些年来，我国在芯片设计、晶圆制造及封测领域已取得长足进步，逐步成为全球半导体产业竞争中的重要力量，但在高性能探针卡、测试座等关键测试接口及其连接组件领域，市场仍由欧美日韩及中国台湾地区少数企业主导，上述半导体测试消耗型硬件的自主可控水平，仍是我国半导体产业向更高层次发展进程中亟待补齐的短板之一。

自成立以来，公司始终将突破以高性能测试座为代表的芯片测试接口技术壁垒、推动关键环节国产替代作为核心发展宗旨。面对产业前沿需求，公司已在 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输等领域取得技术及产品突破，形成了覆盖风冷、液冷方式的多档位散热解决方案，同时实现了 2,000W 高功率测试环境高效散热、精准控温与多工位独立温区控制，可满足 AI HPC、智能手机、汽车电子等应用场景的严苛测试环境需求。公司产品已应用于国产 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，并已服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，加速了高性能芯片封装测试消耗型硬件的国产替代进程，助力了我国集成电路产业的自主可控及升级。

2、公司的技术创新性及其表征

随着高性能芯片通过制程微缩及 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装技术持续向高速率、高频率、高功率方向演进，封装测试消耗型硬件的应用场景日益复杂，对其信号传输完整性与稳定性、高功率散热及精准温控、结构精密程度等方面提出了更高要求，行业技术壁垒和工艺门槛不断提高。

面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”“测试分选套件精密制造”与“高速测试机接口模组制造”六大核心技术体系，能够持续满足高性能芯片测试的前沿需求，产品性能指标与工艺水平已达到行业先进水平：在高速高频领域，公司产品可支持最高 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输；在高功率散热及精准温控领域，公司已开发出适配 2,000W 高功率、满足±1.5℃精准控温的老化测试方案；在精密制造方面，公司测试座产品已实现了万针级高密度布局、250 微米级探针间距以及 110mm×110mm 超大尺寸同轴结构制造；上述行业先进的技术水平助力公司产品精准适配 AI 算力芯片、智能手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片测试需求。

截至本上市保荐书签署日，公司及其子公司拥有 66 项发明专利与 67 项实用新型专利，建有省级企业技术中心及省级集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心，获评国家级专精特新重点“小巨人”企业。

3、公司具有较强的成长性

（1）报告期内主营业务具有成长性

报告期内，公司主营业务收入分别为 22,541.92 万元、30,939.03 万元和 54,368.05 万元，净利润分别为 3,831.75 万元、6,167.86 万元和 13,197.53 万元。受益于 AI 产业化进程加速、高性能 GPU、CPU、SoC 等芯片产品持续升级、半导体封装测试环节国产替代加快以及下游客户需求快速增长，报告期内公司主营业务收入及净利润持续增长，2023 年至 2025 年主营业务收入及净利润的复合增长率分别为 55.30%、85.59%，主营业务保持增长，具有较好的成长性。

（2）公司产品市场空间广阔且快速扩容，多重因素带来更大增长潜力

目前全球半导体封装测试消耗型硬件市场正处于高速扩张期，其增长动力主要来自先进制程与先进封装技术演进、高性能芯片封装测试需求量增长以及封装测试环节复杂化、系统化升级。一方面，先进制程持续逼近物理极限，先进封装技术成为推动芯片算力密度提升的重要手段，封装工艺的复杂性显著提升了芯片测试的复杂度与覆盖率要求；另一方面，AI HPC、先进存储、智能终端、汽车电子及工业控制等下游应用快速发展，带来了海量的高性能芯片测试需求。此外，测试自动化与高并发并行测试技术的进步，也为相关消耗型硬件市场的扩容提供了坚实的基础。

根据 Frost & Sullivan 数据，全球半导体封装测试消耗型硬件市场规模预计将从 2026 年的 332.3 亿元增长至 2030 年的 448.8 亿元，复合增长率为 7.8%；中国大陆市场预计将从 2026 年的 61.1 亿元增长至 2030 年的 87.7 亿元，复合增长率为 9.4%。相较全球市场，中国大陆半导体封装测试消耗型硬件市场在高性能芯片自主可控需求及技术迭代等多重有利因素的推动下呈现出强劲的增长态势，并为具备相应核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力的国产厂商带来持续的业务增长动能。

（3）公司成长性以核心技术为支撑

面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成六大核心技术体系。

报告期内，公司核心技术全面应用于各系列封装测试消耗型硬件及其相关配件产业化，核心技术产品收入占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	52,787.90	29,753.45	21,445.29
营业收入	54,402.48	30,951.23	22,547.96
占比	97.03%	96.13%	95.11%

在测试座领域取得了领先行业地位的同时，公司依托自身核心技术体系及行业内在发展逻辑，持续在封测接口组件、WLCSP 探针卡、负载板、微流道液冷板等高附加值业务领域进行战略布局，为公司的持续发展和市场竞争提供了坚实的技术底座。

（4）半导体产业变革为公司提供新一轮成长机遇

当前，全球半导体测试产业正经历深刻的结构性变革。在 AI HPC 等应用驱动下，先进制程与先进封装的协同演进，推动半导体封装测试消耗型硬件的性能全面对标高频高速、高功率、大尺寸等高阶测试需求。先进封装带来的千瓦级单封装功耗、数万根引脚的超高密度布局以及快速增长的信号频率与传输速率，推动芯片测试环节由传统的单一成品测试（FT）、快速筛选演进为复杂全功能验证，叠加长达数小时的老化测试（Burn-in）和系统级测试（SLT），芯片测试的复杂度与耗时快速上升，测试环节的重要性及价值量显著提升。

同时，产业结构性变革也对芯片测试接口企业的技术能力、产能规模及解决方案完整性构成严峻挑战。客户对测试接口的性能指标、交付周期、研发能力及全生命周期服务能力的要求持续提升；叠加地缘政治格局变化与国产替代需求日益迫切，共同推动半导体测试领域的全球竞争格局加速重塑，国产替代窗口加速开启。

公司是行业领先的半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，公司产品主要应用于 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域。公司客户群体已涵盖境内外知名芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业。公司坚持以核心技术持续突破为底层支撑，以早期介入客户芯片设计、共同开发的协同模式构建差异化壁垒，并在此基础上全面实施“技术领先、产品延伸、平台化发展”战略，在历史性的产业结构变革机遇中，未来伴随国产半导体测试消耗型硬件解决方案需求量的提升，公司的业绩有望随之增长。

综上，公司符合创业板定位。

四、发行人符合上市条件

（一）发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件

保荐人依据《公司法》《证券法》相关规定，对发行人是否符合首次公开发行股票条件进行了逐项核查，核查情况如下：

1、根据与本次发行上市有关的股东会决议，发行人本次拟发行的股票为每股面值1元、并在深交所上市的人民币普通股（A股）股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百四十三条之规定。

2、根据与本次发行上市有关的股东会决议，发行人股东会已就本次发行股票的种类、数额、价格、起止时间等作出决议，符合《公司法》第一百五十一条之规定。

3、根据发行人与中信证券签署的保荐协议，发行人本次发行上市由具有保荐资格的中信证券担任保荐人，符合《证券法》第十条第一款之规定。

4、发行人已经制定相应的股东会、董事会、审计委员会议事规则和内部治理制度，已经建立了健全的股东会、董事会、独立董事、董事会秘书和各专门委员会，上述机构和人员能够依法履行职责。发行人已具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、根据天健会计师出具的《审计报告》及《非经常性损益鉴证报告》，发行人2023年、2024年、2025年净利润（归属于公司普通股股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为3,447.42万元、5,647.92万元、12,339.83万元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据天健会计师出具的《审计报告》，发行人报告期内的财务会计报告经审计机构审计并出具了无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据相关政府部门出具的合规证明，发行人实际控制人的无犯罪记录证明，以及发行人及其实际控制人出具的声明与承诺，并通过互联网进行查询，发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

8、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

（二）发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

1、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身法特迪有限成立于 2014 年 2 月 11 日，于 2023 年 11 月 22 日以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。保荐人认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

发行人已经依法建立健全股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。保荐人认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，保荐人认为，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定。

2、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕4728 号），保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

经核查发行人的内部控制制度、内部控制执行记录，结合天健会计师出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕4729 号），保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

综上，保荐人认为，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的

规定。

3、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及查阅发行人董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员出具的调查表，保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户、发行人工商档案及股东名册、聘任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的股东（大）会决议和董事会决议、核心技术人员的劳动合同以及访谈文件、发行人实际控制人出具的声明和承诺，结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件、企业信用报告、发行人涉及的诉讼仲裁、行业研究、分析报告等资料，结合与发行人管理层的访谈、天健会计师出具的《审计报告》和发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

综上，保荐人认为，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定。

4、发行人申请首次公开发行股票符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策，发行人及其实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员出具的调查表，董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、实际控制人提供的无犯罪证明、个人征信报告，取得发行人住所地相关主管政府单位出具的证明文件，查询中国证监会、证券交易所等监管机构网站及其他公开信息，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和实际控制人不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

综上，保荐人认为，本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定。

（三）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

1、如前文所述，发行人本次发行上市符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的各项发行条件。据此，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。

2、本次发行前，发行人的股本总额为人民币 3,900.00 万元，本次拟发行面值为人民币 1.00 元的人民币普通股不超过 1,300.00 万股，发行后发行人股本总额不超过人民币 5,200.00 万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、本次发行前，发行人的股本总额为人民币 3,900.00 万元，本次拟公开发行新股的数量不超过 1,300.00 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

发行人 2024 年度及 2025 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 5,647.92 万元和 12,339.83 万元，最近两个会计年度净利润均为正数且累计净利润为 17,987.75 万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项和第 2.1.2 条第一款第（一）项的规定。

综上所述，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

第五节 上市后持续督导工作安排

一、持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；

二、有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、深圳证券交易所报告；

三、按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；

四、督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

五、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

六、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

七、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

八、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

九、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

十、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

保荐代表人：

孟　硕

王风雷

项目协办人：

王　娴

中信证券股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

内核负责人：

邱志千

中信证券股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

保荐业务负责人：

孙　毅

中信证券股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 6 月 29 日